

## 【新製品】電子パッケージング向け10μm以下に対応可能なレーザー直描装置を発表

2011年11月9日－MicronicMydataAB(マイクロニック・マイデータ、本社：スウェーデン、日本法人：マイクロニック・マイデータ・ジャパン株式会社、東京都府中市、代表取締役社長：河田卓)は本日、台湾(台北)で開催されているTPCAshowで、MPUパッケージやより小型・薄型化したモバイル電子機器の製造に革新的な進歩をもたらす新製品、レーザー直描装置(LDI)を発表しました。マイクロニック・マイデータLDI5sシリーズと呼ばれる新技術は、先端プリント配線板に実装される複雑な電子パッケージの製造に使用される有機素材ICパッケージ基板メーカーをターゲットとしています。現在の製造技術では、解像力10μm以下という高レベルの精度と精密なアライメントを実現しながらかつ現行の製造スピードを維持することが非常に困難になってきています。

### 生産性を上げるLDIの可能性再考

マイクロニック・マイデータ社長兼CEO Peter Uddforsのコメント：

「飛躍的進歩となるこの技術は、モバイル電子機器産業全体で増加しているより高度な要求に対応する直描装置の可能性について多くの方々に再考を促すでしょう。当社にとって、革新的な次世代のLDI技術は必然的な一歩でした。当社が長年培った描画の専門技術と、将来の生産性要求に沿って自らの製造ロードマップを構築しなければならないお客様に対して最先端技術をご提供するという強いコミットメントの結合の結果生まれたものです。当社のLDI5sシリーズは、エレクトロニクス産業をリードするアメリカとアジアのお客様において評価が進められている段階であり、2012年に製品出荷を開始致します。」

### パッケージ基板メーカーの将来に向けて

世界のエレクトロニクス産業において25年の実績を持つマイクロニック・マイデータは、有機素材基板上に10μm以下レベルでダイナミックな非線形アライメント要求に対応するという、満たされていないニーズを認識しました。より高性能なマイクロプロセッサやより薄型化が進むスマートフォン、タブレットPC等により機能性の要求は増加し、より狭い面積上により狭ピッチでより多ピン化されたパッケージ基板のニーズが高まっています。ムーアの法則にドライブされ、基板メーカー各社は低コストの有機素材とレジスト上で、線幅の縮小化やより厳格なレイヤー間の重ね合わせ精度の実現を求められています。

### 解像度とアライメント - 高速で

マイクロニック・マイデータ Product Area Director Henrik Sjöbergのコメント：

「当社のLDIが市場の他の製品と異なる点は、精度とアライメントに対する次世代の要求に対応出来るのと同時に、製造のフルスピードが維持出来る点です。当社の描画に関する専門技術を基としたこの装置は、SLM(空間光変調器)技術、高速データ処理、精密機構等といった当社独自の新機軸が組み合わされています。優れた解像度とアライメント、比類なき生産性でお客様のハイエンド描画実現に貢献します。」

\*\*\* 本件に関するお問い合わせ先 \*\*\*

マイクロニック・マイデータ・ジャパン株式会社

Tel: 042-354-1329 Fax: 042-354-1321

広報担当 梁瀬 恵美子

E-mail: [info@micronic.co.jp](mailto:info@micronic.co.jp)